**压低温项目第二期工作安排**

提交：吕刚立

时间：2017/5/18

1. 背景：

压低温测温控制板完成两块控制板硬件功能的基本调试，具备系统工程开发的条件。

1. 工作内容分配如下

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程师 | 工作重点 | 主要工作内容 | 备注 |
| 吕刚立 | 1.负责整体项目进度 | 1.跟进注册部协商事宜 | 实现单片机制冷，制热控制模块。 |
| 2.负责注册部协商注册方案事宜 | 2.水箱工程设计的验证；水箱温场的验证； |
| 3.负责控温参数的系统设计及实现 |
| 4.负责系统软件架构及部分驱动的实现 | 3.软件工程架构的实现；串口，E2PROM驱动实现。 |
| 刘静勇 | 1.负责测温系统设计精度的实现 | 1.测温放大电路的硬件设计验证 | 研究及验证电路纹波，干扰，电压精度水平，提交调试文件及问题纪录 |
| 2.AD转换电路的校准验证 |
| 2.负责部分驱动的实现 | 3.负责扫描键盘，单线E2PROM驱动的实现， |
| 3.负责交付调试完成的控制板 | 4.交付控制板于其它工程人员，并跟进相关问题。 |
| 4.负责深圳精东控制显示屏方案的跟进 | 5.密切跟进供应商进度。 |
| 朱繁盛 | 1.负责亚低温整机功能的实现与调试 | 1. 验证驱动实现的正确性 | 实现单片机校准模块 |
| 2.负责珠海控制显示屏方案的跟进 | 2. 测温校准验证流程的实验与验证 |
| 3. 跟进软件框架及功能说明，实现相关功能。 | 实现数据读写，系统逻辑，显示驱动，温度检测模块 |
| 4. 密切跟进供应商进度。 |
| 陈霄 | 1.负责协助朱工实现部分功能代码 | 1.辅助朱工调试整机代码功能 | 无 |
| 2.负责收集测温系统验证数据 | 2.运行自动测温验证及校准平台，进行对测温系统的验证数据收集 |